

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2004 年 11 月 4 日 (04.11.2004)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2004/095831 A1

- (51) 国際特許分類: H04N 5/335, H01L 27/146
(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/005334
(22) 国際出願日: 2004 年 4 月 14 日 (14.04.2004)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ: 特願2003-120343 2003 年 4 月 24 日 (24.04.2003) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 浜松ホトニクス株式会社 (HAMAMATSU PHOTONICS K.K.) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 Shizuoka (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小林 宏也 (KOBAYASHI, Hiroya) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 赤堀 寛 (AKAHORI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜

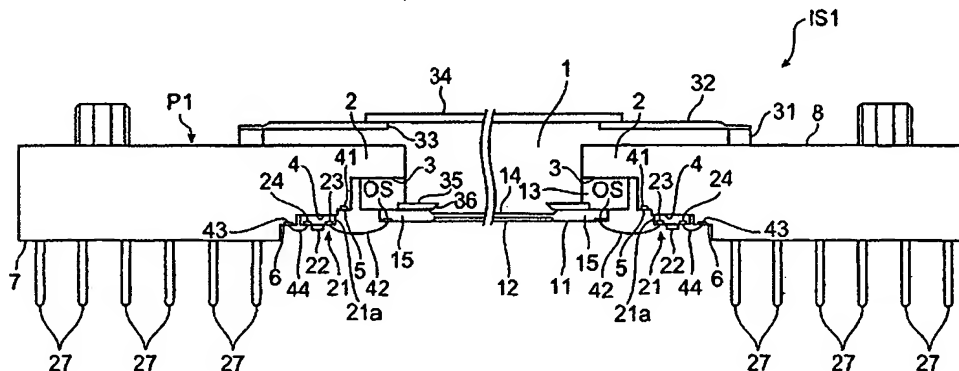
- 松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP). 村松 雅治 (MURAMATSU, Masaharu) [JP/JP]; 〒4358558 静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内 Shizuoka (JP).
(74) 代理人: 長谷川 芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目10番6号 銀座ファーストビル 創英国際特許法律事務所 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG,

[続葉有]

(54) Title: SOLID-STATE IMAGING DEVICE

(54) 発明の名称: 固体撮像装置



(57) Abstract: A solid-state imaging device (IS1) comprising a package (P1), a CCD chip (11) and a chip resistance array (21). A mounting unit (2) for mounting the CCD chip (11) and the chip resistance array (21) thereon is provided to the package (P1) so as to protrude into a hollow (1). The mounting unit (2) has a first plane unit (3) and a second plane unit (4) that are formed with a step difference. The CCD chip (11) is placed on the first plane unit (3) via a spacer (13) and fixed. The chip resistance array (21) is placed on the second plane unit (4) and fixed. The chip resistance array (21) is disposed so as to be closed to the CCD chip (11) by using the step difference between the first plane unit (3) and the second plane unit (4).

(57) 要約: 固体撮像装置 IS1 は、パッケージ P1、CCD チップ 11、チップ抵抗アレイ 21 等を備える。パッケージ P1 には、CCD チップ 11 及びチップ抵抗アレイ 21 を載置するための載置部 2 が中空部 1 に突出するように設けられている。載置部 2 は、第 1 の平面部 3 と第 2 の平面部 4 とを有し、第 1 の平面部 3 と第 2 の平面部 4 とは、段差を有して形成されている。CCD チップ 11 は、スペーサ 13 を介して第 1 の平面部 3 上に載置され、固定される。チップ抵抗アレイ 21 は、第 2 の平面部 4 上に載置され、固定される。チップ抵抗アレイ 21 は、第 1 の平面部 3 と第 2 の平面部 4 との段差を利用して、CCD チップ 11 とチップ抵抗アレイ 21 とが近接して配置される。



KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:

— 国際調査報告書